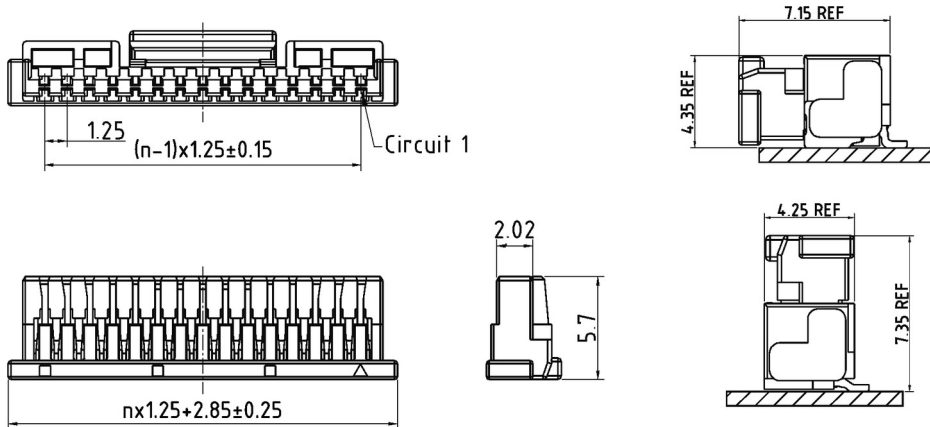
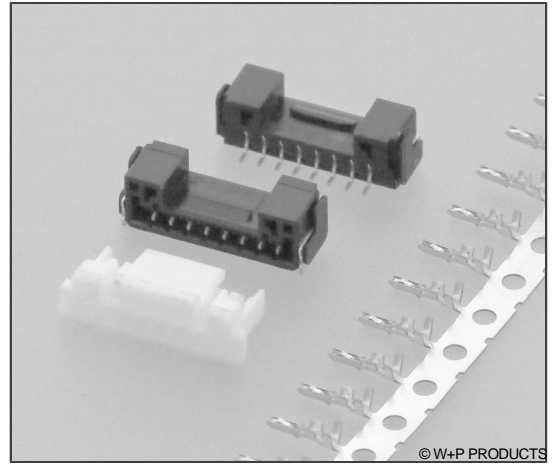


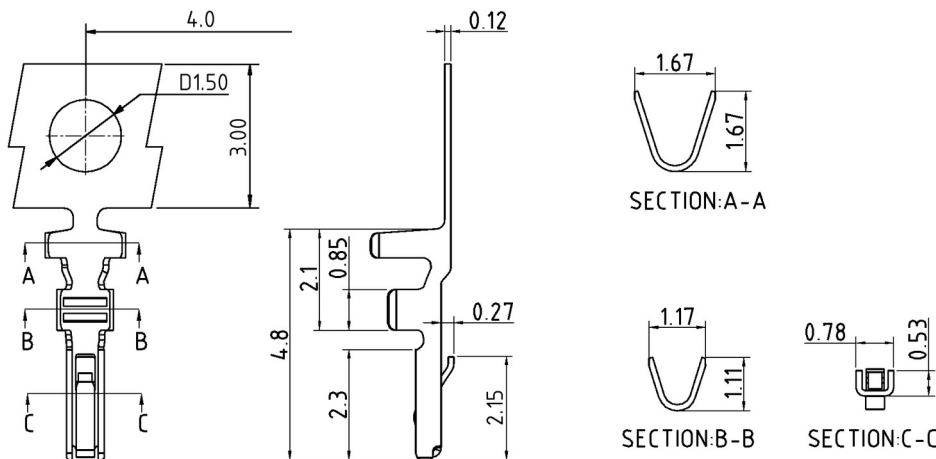
SMT-Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,25mm – mit Verriegelung SMT Friction Lock Headers / Crimp Housings, 1.25mm Pitch – with Lock

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0, halogenfrei <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0, halogen free</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 30 ~ 26 <i>AWG 30 ~ 26</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 30 mΩ <i>< 30 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 100 MΩ <i>> 100 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC <i>500 V AC</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	50 V AC/DC <i>50 V AC/DC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A AC/DC <i>1 A AC/DC</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-25 °C ... +85 °C <i>-25 °C ... +85 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



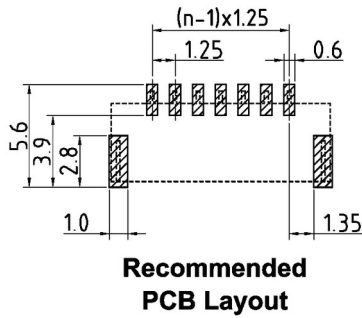
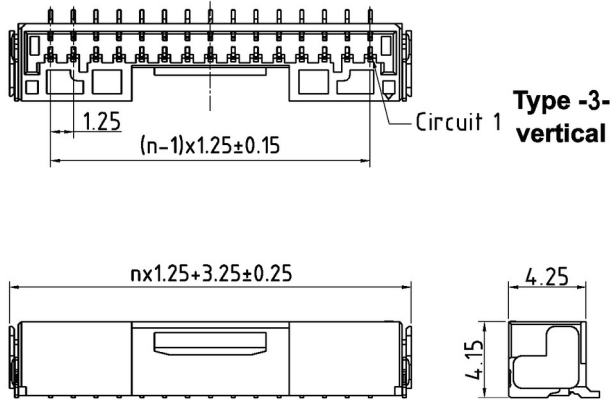
Series	Contacts*	Type	Colour
5632	04 02-15	1 1 Buchsengehäuse <i>Female Housings</i>	70 70 Standard: Weiß <i>Standard: White</i>



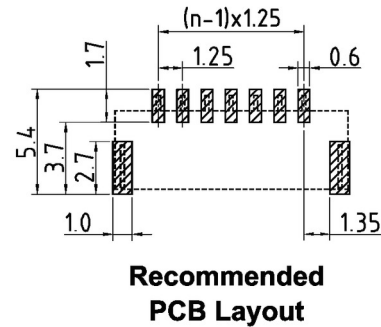
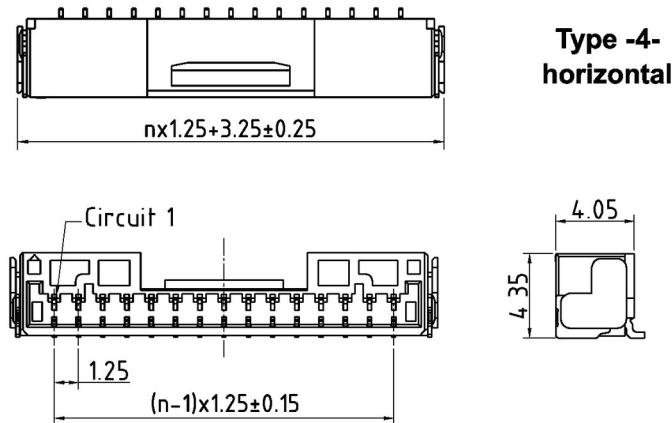
Series	Contacts	Type	Plating
5632	01	2 2 Buchsenkontakte <i>Female contacts</i>	50 50 Sn

5632

SMT-Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,25mm – mit Verriegelung
 SMT Friction Lock Headers / Crimp Housings, 1.25mm Pitch – with Lock



Series	Contacts*	Type	Plating	Colour	Packaging
5632	04 02-15	3 3 Stiftleiste stehend Male connector vertical	50 50 Sn	10 10 Standard: Schwarz Standard: Black	FTR FTR



Series	Contacts	Type	Plating	Colour	Packaging
5632	04	4 4 Stiftleiste liegend Male connector horizontal	50	10 10 Standard: Schwarz Standard: Black	TR TR

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:

- FTR Tape & Reel mit Film-Pad / Tape & Reel with Film-Pad
- TR Tape & Reel ohne Pick & Place Pad / Tape & Reel w/o Pick & Place Pad

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

